

1934354-1 ✓ AKTIV

Z-PACK | Z-PACK TinMan

Interne TE-Nummer 1934354-1

High Speed Backplane Connectors, Board-to-Board, 96 Position,
Mating Alignment, Guide Slot Mating Alignment Type, 12 Row, 8
Column, Z-PACK TinMan

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Backplane-Steckverbinder > Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder



Steckverbindersystem: **Leiterplatte-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **96**

Reihenabstand: **1.4 mm [.055 in]**

Gegensteckführung: **Mit**

Typ der Gegensteckführung: **Führungsanschluss**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Signalanordnung	Differenzial
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Hülsen-Ausführung	Vollständig ummantelt
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Paare pro Spalte	4
Anzahl der Paare	32
Stapelbar	Nein
Anzahl der Signalpositionen	64
Anzahl von Positionen	96
Zeilenanzahl	12
Spaltenanzahl	8
Backplane-Architektur	Koplanar
Montageausrichtung für Leiterplatte	Rechter Winkel

Elektrische Kennwerte

UL-Nennspannung	250 VAC
-----------------	---------



Impedanz	100 Ω
----------	-------

Arbeitsspannung	250 VAC
-----------------	---------

Signalmerkmale

Differenzialimpedanz	100 Ω
----------------------	-------

Anzahl der Differenzialpaare pro Spalte	4
---	---

Datenrate	10 Gb/s
-----------	---------

Sonstige Eigenschaften

Abschirmungsmaterial	Phosphorbronze
----------------------	----------------

Kontaktmerkmale

Länge des Steckbereichs des Kontakts	6 mm [.236 in]
--------------------------------------	----------------

Dicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	.5 μm [20 μin]
---	----------------

Kontakttyp	Stift
------------	-------

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
--	------

Oberfläche des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Matt
--	------

Kontaktform	Rechteckig
-------------	------------

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
---	------

Kontaktmaterial	Phosphorbronze
-----------------	----------------

Kontakt-nennstrom (max.)	.5 A
--------------------------	------

Klemmenmerkmale

Anschlussstift- und Restlänge	2.2 mm [.087 in]
-------------------------------	------------------

Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage – Press-Fit
-------------------------------------	-------------------------------

Montage und Anslusstechnik

Führungskomponenten	Ohne
---------------------	------

Gegensteckarretierung	Ohne
-----------------------	------

Montageausrichtung der Leiterplatte	Ohne
-------------------------------------	------

Arretierung für Leiterplattenmontage	Mit
--------------------------------------	-----

Art der Leiterplattenmontage	Aktions-/Kompatibles Endstück
------------------------------	-------------------------------

Gegensteckführung	Mit
-------------------	-----

Typ der Gegensteckführung	Führungsanschluss
---------------------------	-------------------

Art der Steckverbinder-montage	Leiterplattenmontage
--------------------------------	----------------------

Gehäusemerkmale

Anzahl der gehüllten Seiten	Vierseitig
Endwandposition	Doppelt
Gehäusematerial	LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
Gehäusefarbe	Schwarz
Raster	1.9 mm[.075 in]

Abmessungen

Steckverbinderlänge	18.05 mm
Steckverbinderhöhe	20.2 mm
Steckverbinderbreite	33 mm
Leiterplattendicke (empfohlen)	1.57 mm[.062 in]
Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser	.47 mm
Reihenabstand	1.4 mm[.055 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-65 – 90 °C[-85 – 194 °F]
---------------------------	---------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Signal
----------------------	--------

Industriestandards

UL-Grad	Anerkannt
UL-Dateinummer	E28476
Behörde/Norm	UL
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Karton & Schlauch, Karton & Schlauch, Tube
--------------------	--

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233)



Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224)
Enthält keine SVHC

Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile




TE Teilnr.: 1934222-1
Tin Man Recept Assy 4Pair8Column

Auch serienmäßig | Z-PACK TinMan



Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge (2)



Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder(65)

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:2057629-1
CFP Module Conn Assy



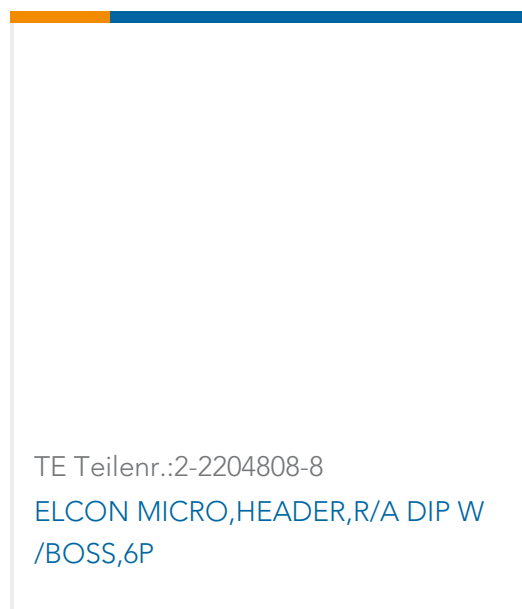
TE Teilnr.:1934222-1
Tin Man Rcpt Assy 4Pair8Column



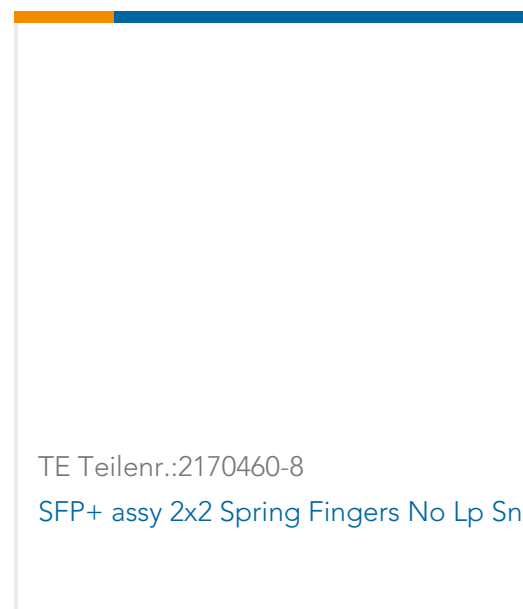
TE Teilnr.:1934312-1
TinMan Header Assy 4x10Double



TE Teilnr.:1934544-1
Tinman Vt Rcpt Assy 4pr 10col



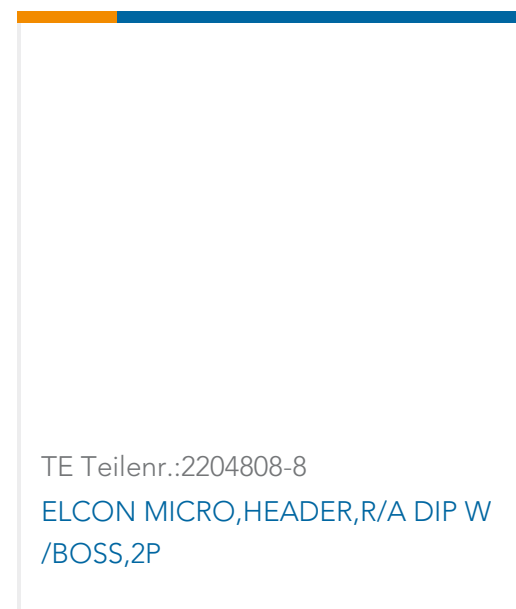
TE Teilnr.:2-2204808-8
ELCON MICRO,HEADER,R/A DIP W /BOSS,6P



TE Teilnr.:2170460-8
SFP+ assy 2x2 Spring Fingers No Lp Sn



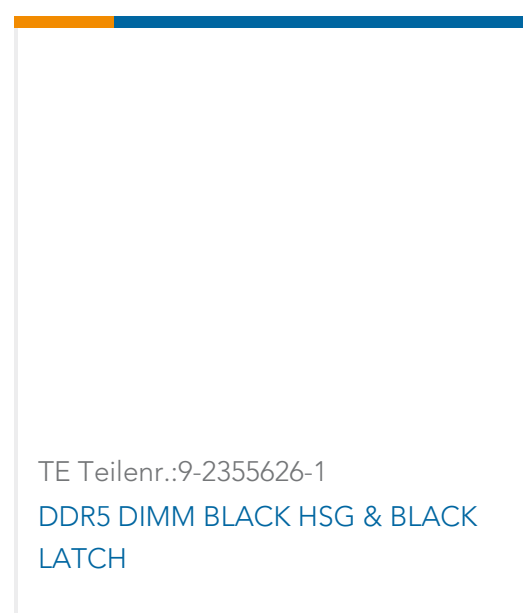
TE Teilnr.:2187690-1
SW PIR HDR BP, 92OHM, 6X6 OE



TE Teilnr.:2204808-8
ELCON MICRO,HEADER,R/A DIP W /BOSS,2P



TE Teilnr.:2325259-1
RA REC ASSY 4X6, 92OHM PIR WHISPER R



TE Teilnr.:9-2355626-1
DDR5 DIMM BLACK HSG & BLACK LATCH

Dokumente

Produktzeichnungen

[TinMan R/A Header Assy 4x8 Double](#)

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1934354-1_B.2d_dxf.zip](#)

Englisch

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1934354-1_B.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1934354-1_B.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten



High Speed Backplane Connectors catalog - Z-PACK TinMan High Speed, High Density Backplane Connector

Englisch

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch